SEMICON Japan通信 2026 Vol.3



12.9（水）-11（金）東京ビッグサイトにて開催

SEMICON Japan 2026
来場登録受付中！

来場登録はこちら

半導体は設計する時代へ：ADIS特集

ADIS Advanced Design Innovation Summit

半導体は「つくる」だけでなく、「設計する」時代へ。

AIの進化やシステムの高度化により、半導体とソフトウェアを一体で捉えたシステム設計の重要性がますます高まっています。
ADISでは、「何を設計するのか」「設計をビジネス戦略にどう つなげるのか」をテーマに、システムアーキテクチャー、半導体設計・検証の最前線を議論します。

セミナー

ADIS-1 Agentic AI時代のシステム設計
半導体は設計する時代を超え、
「設計分野でのAgentic AIは人を超えるのか！？」を大激論
12/10（木）13:30 - 15:00
TechSTAGE SAKURA（会議棟 605-606会議室）半導体設計の世界にも、本格的なAI活用の波が押し寄せています。昨年の「設計におけるAI活用」からさらに一歩踏み込み、今年は「Agentic AIは設計分野で人を超えるのか！？」をテーマに徹底議論 - Agentic AIがもたらすメリットや課題、半導体設計の未来を業界の有識者とともに考えます。

ADIS-2 宇宙半導体編
宇宙産業を拓く次世代半導体設計最前線
12/10（木）15:30 - 17:00
TechSTAGE SAKURA（会議棟 605-606会議室）衛星コンステレーションや宇宙データ活用の拡大を背景に、注目を集める宇宙向け半導体・AI・SoC・宇宙インフラを支える半導体には、どのような設計技術が求められるのか。宇宙産業を支える最先端の半導体設計技術と、新たに広がる事業機会を探ります。

ADIS-3 光電融合編
光電融合デバイス開発最前線
12/10（木）17:30 - 19:00
TechSTAGE SAKURA（会議棟 605-606会議室）AIデバイスのさらなる進化に向け、大きな課題となる低消費電力化・その解決策として期待されているのが、光と電気を融合する「光電融合」です。技術開発が進む今、どのようなアプローチが次世代をリードするのか。アーキテクチャー、設計・デバイス開発・それぞれの視点から最新動向を議論します。

Pick Up スピーカー


坂本 佳史
DigitalBlast / SpaceBlast


石井 康雄
Tensorrent USA


川上 哲志
九州大学


布谷 伸浩
NTT

詳細はこちら

The Game：SoC設計を学ぶ講義とハンズオンによるカリキュラム

半導体の未来を創るために～SoC設計セミナー

講義と専用カードを使ったハンズオンを組み合わせ、SoC（System on a Chip）設計のプロセスを模擬体験できる参加型プログラムです。SoC設計の全体像や考え方を体系的に学ぶだけでなく、講義で得た知識を実践につなげることで、座学だけではつかみにくい設計プロセスへの理解を深めます。
「学ぶ」と「体験する」を行き来しながら、半導体設計のリアルに触れられる「The Game」で、これからのキャリアにつながる実践的な学びを体験してみませんか？
※事前の手続きが完了している方のみご参加いただけます。

日時：12/9（水）9:30 - 18:00
会場：会議棟610会議室

詳細はこちら

Circuit Design Speed Contest：全国高専生対象半導体設計競技会

未来の半導体設計を担う、全国の高専生が集結！

半導体業界の未来を担う若手人材の育成を目的に、全国の高専生が設計技術に挑む「SEMI Circuit Design Speed Contest」を開催します。2025年にスタートし、今年で2回目を迎える本コンテストでは、次世代のエレクトロニクス産業を担う学生たちが、半導体製造・設計をテーマに競い合います。
今年は9月から全国19の高専において予選会を実施し、九州から北海道まで各地域の学生たちが設計課題に挑戦しています。各校の代表者がSEMICON Japanに集結し、日本一をめざして決勝大会に臨みます。
若き才能が日頃培った知識と技術を発揮し、半導体設計の可能性に挑む姿にぜひご注目ください。未来の半導体産業を支えるエンジニア誕生の瞬間をお見逃しなく。

12/10（木）9:30～13:00
TechSTAGE YUZU（会議棟 102会議室）

詳細はこちら

その他、業界最前線を網羅するセミナーも多数開催！
＼気になったセミナーはお気に入り★をクリック／

セミナー一覧はこちら

特集記事


SEMICON Japan 2026 未来を探る視点2
技術開発のタネとなる知識が期待される半導体業界・先端情報の共有で時代の要請に応える「STS 2026」

業界動向・SEMIの活動アップデート

市場動向


300mmファブ装置の世界投資額が2029年に2,270億ドル へ到達
世界的な300mm投資が堅調に推移する中、米国の建設計画も拡大

政策動向


【SEMI会員限定】
SEMI Japan Policy Report 10月号

SEMICON Japan 2026 スポンサー

Platinum Sponsors

DISCO　HIGHTEC SYSTEMS　HITACHI Hitachi High-Tech
SCREEN Innovation for a Sustainable World　TEL

Gold Sponsors

ADVANTEST　APPLIED MATERIALS.　ASM　EBARA
FUJIFILM　JSR　KLA　KOKUSAI ELECTRIC
Lam RESEARCH　MJC　Nikon　Qnity
TERADYNE　ACCRETECH 東京精密

Silver Sponsors

JX金属　TOWA

Workforce Development Sponsors

HORIBA　muratec　SMCO　TRENG

（10月21日現在、社名アルファベット順）

開催概要

半導体 これまでの50年 これからの50年

日　時：12月9日（水）- 11日（金）10:00 - 17:00
会　場：東京ビッグサイト
　　有明セントラルタワーホール&カンファレンス
　　TFTビル
費　用：展示会無料・セミナー一部有料

公式Webサイトはこちら

同時開催







〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-4-1